



#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology

강력한 점착력에 의한 신뢰 할 수 있는 고정 테이프
내열 폴리 이미드 기재 테이프

170 Series

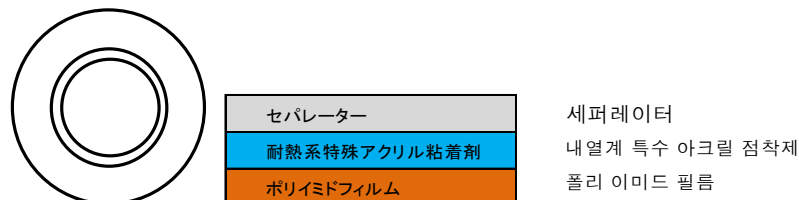
특징

- ①고온화에도 우수한 점착력
- ②급속 뿐만 아니라 각종 수지에도 좋은 성능을 발휘
- ③실내공기오염 가이드라인(후생노동성)지정 포름알데히드·아세트알데히드·톨루엔 등 VOC지정 13물질을 구성재료에 사용하지 않음

용도

- 전자부재 고정
- 반도체 칩 마스크 등

構成



특성

일반특성/점착특성 (상태 점착력) 측정조건 (JIS Z0237준거)·그 외 특성

제품	기재 (μm)	점착제 (μm)	Peel Adhesive(N/25mm) SUS
179X1	5	5	3.5

※제품 문의는 당사영업 (TEL:04-2944-5151 FAX:04-2944-1396 Mail:info@kgk-tape.co.jp) 에 상담하여 주십시오

【사용 상 주의】

기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.